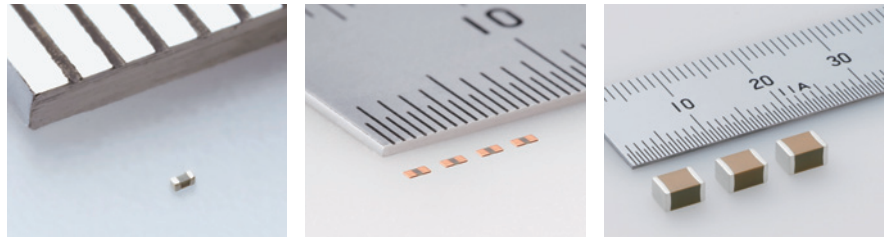


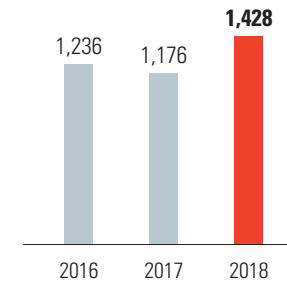
主力商品	売上高構成比 (2018年3月期)	売上高の推移 (単位:億円)	営業概況
------	----------------------	-------------------	------

コンデンサ

- 積層セラミックコンデンサ



超小型積層セラミックコンデンサ 0201サイズ(0.25mm×0.125mm) 超低背積層セラミックコンデンサ 1005サイズ(1.0mm×0.5mm) 薄さ0.11mm 小型大容量積層セラミックコンデンサ 4532サイズ(4.5mm×3.2mm) 1,000μF

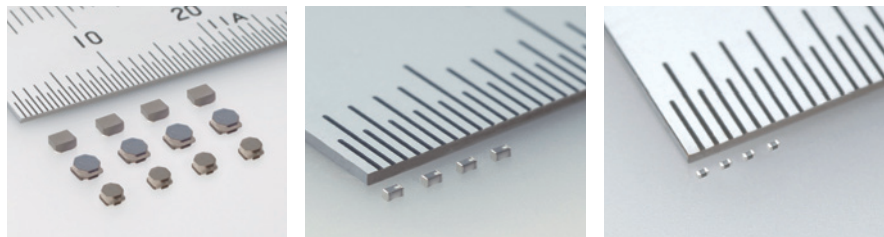


小型、薄型、大容量、高信頼性の積層セラミックコンデンサの開発に注力しています。誘電体の材料技術、薄層・大容量化技術および超小型品生産技術等を高度化することにより、最先端の積層セラミックコンデンサを開発し続けています。

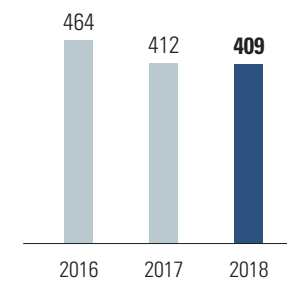
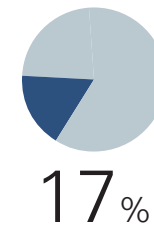
2018年3月期の業績は、すべての機器向けの売上が前期と比べ増加したことにより、売上高は21.4%増の1,428億58百万円となりました。

フェライト及び応用製品

- 巻線インダクタ
- 積層チップインダクタなどの各種インダクタ商品



メタル系パワーインダクタ [MCOIL™(エムコイル)] 高周波積層High-Qチップインダクタ 超小型積層チップインダクタ

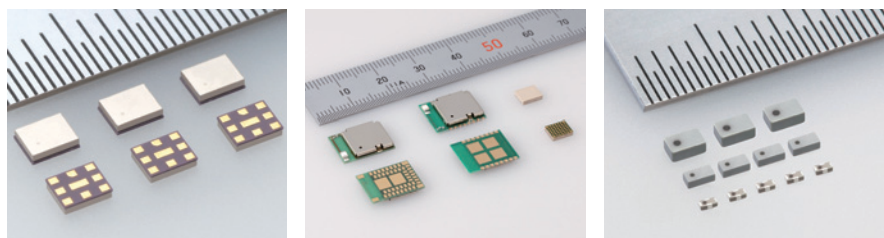


小型、薄型、大電流対応のインダクタに加え、自動車・産業機器をターゲットとした大型、高信頼性のインダクタの開発に取り組んでいます。材料開発、巻線・積層プロセス技術を高度化させることで、競争力ある商品を開発しています。

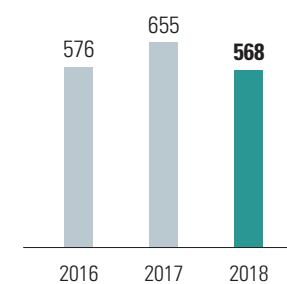
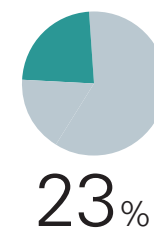
2018年3月期の業績は、民生機器向け、自動車・産業機器向けの売上が前期と比べ増加したものの、情報機器向け、通信機器向けの売上が前期と比べ減少したことにより、売上高は0.7%減の409億77百万円となりました。

複合デバイス

- モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)
- 電源モジュール
- 高周波モジュール
- 部品内蔵配線板「EOMIN™(イオミン)」



モバイル通信用デバイス (FBAR/SAW) 高周波モジュール 積層セラミックフィルタ

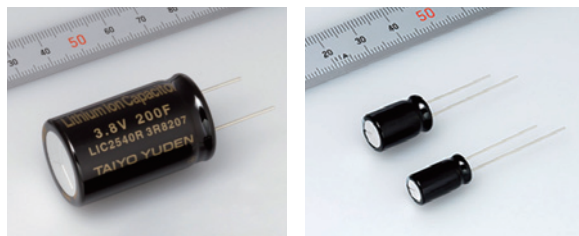


モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)の技術およびLTCC技術をコアとした新商品の開発、第5世代移動通信システムに向けた次世代商品の開発、注力市場に向けて当社のコア技術を融合したソリューション型商品の開発に注力しています。

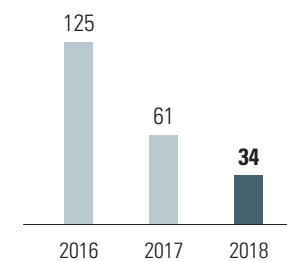
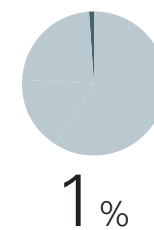
2018年3月期の業績は、モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)等の売上が前期と比べ減少したことにより、売上高は13.3%減の568億38百万円となりました。

その他

- エネルギーデバイス



シリンダ型リチウムイオンキャパシタ シリンダ型電気二重層キャパシタ



主に自動車電装および高信頼性市場へ向けエネルギーデバイスの商品開発に注力しています。

2018年3月期の業績は、前期比44.4%減の34億43百万円となりました。